

5-104071-1 ✓ AKTIV

AMPMODU | AMPMODU System 50

Interne TE-Nummer 5-104071-1

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 1.27 mm

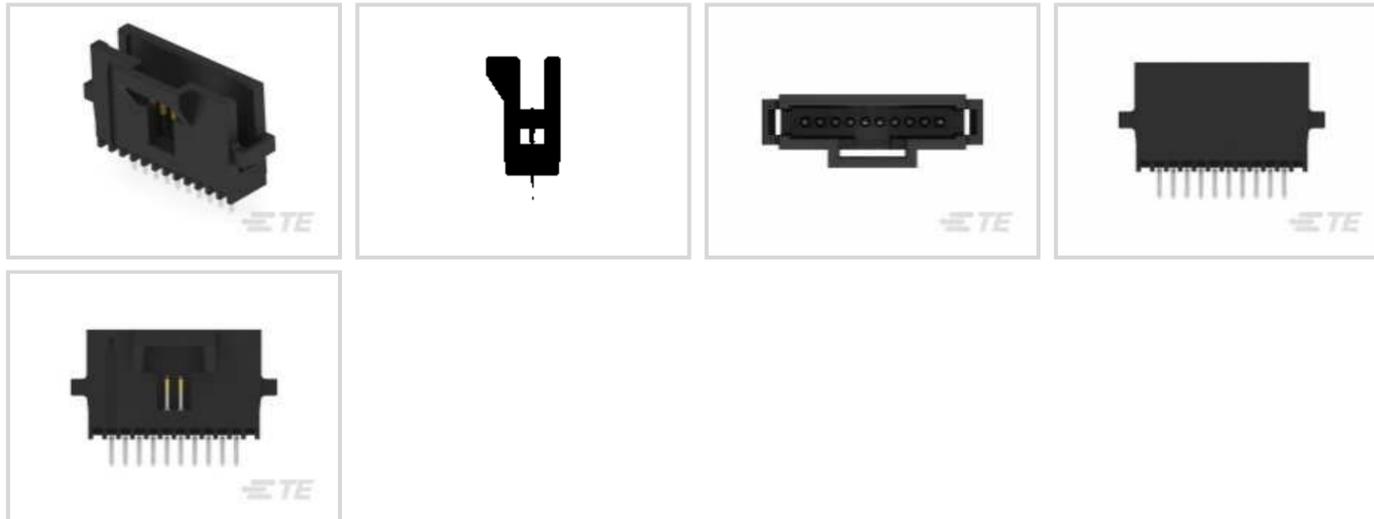
[.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder,

AMPMODU System 50

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: 10

Zeilenanzahl: 1

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	10
Zeilenanzahl	1
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	500 VAC
Isolierwiderstand	5000 MΩ



Arbeitsspannung	30 VAC
-----------------	--------

Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.38 mm[.015 in]
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	3.81 – 6.35 µm[150 – 250 µin]
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Rechteckig
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm[30 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3.6 A

Klemmenmerkmale

Runder Endverschluss, Anschlussstift- und Restdurchmesser	.38 mm[.015 in]
Anschlussstift- und Restlänge	2.54 mm[.1 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten

Montage und Anslusstechnik

Gegensteckarretierung	Mit
Typ der Gegensteckarretierung	Verriegelung, Verriegelung, Verriegelung, Verriegelung
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	1.27 mm[.05 in]
Gehäusematerial	LCP

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm [.062 in]
--------------------------------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Gehäusenentemperatur	Hoch
Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]

Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

UL-Grad	Zulassung
Behörde/Norm	CSA, UL
Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	28
Verpackungs-Typ	Kasten, Rohr

Weitere

Ausgelassene Positionen	0
-------------------------	---

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMPMODU System 50



Kunden kauften auch diese Produkte





TE Teilnr.:5747461-5
HD-20 RCPT 25P RA 590 FFSCRLK



TE Teilnr.:638444-9
HEADER ASSEMBLY R/A UNSEALED 1



TE Teilnr.:5054412014
RNF-100-1/4-5-STK



TE Teilnr.:5-104071-3
15 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD SN



TE Teilnr.:5-1123723-5
3.96 EP HDR ASSY 5P(BLACK)

Dokumente

Produktzeichnungen

[10 SYSTEM 50 HDR SRST SHRD SN](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104071-1_T.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104071-1_T.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-104071-1_T.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_5-104071-1_071820181437_dmtec](#)



Englisch

[MD_5-104071-1_071820181437_dmtec](#)

Englisch